

G-33 材料科學與工程 學系(所) 98 學年度入學	碩士班研究生畢業條件明細表						
項 目	備 註						
一、修業年限： 1. 最低修業年限：1 年 2. 最高修業年限：4 年（不包括休學年限 2 年）	在職生得延長修業年限一年						
二、應修最低畢業總學分共 <u>31</u> ，包括下列兩項： 1. 學 科：必修最低 <u>1</u> 學分、選修最低 <u>24</u> 學分。 2. 畢業論文： <u>6</u> 學分	研究生學業及操行成績均以 70 分為及格。 操行成績不及格者，予以退學。 學業平均成績佔畢業成績 50% ※必修+選修+畢業論文=最低畢業總學分。						
三、抵免學分：最高 <u>12</u> 學分	依本校抵免學分辦法，並應於入學當學期加選選課程截止日期前申請抵免。						
四、選修大學部相關課程計入研究所畢業學分	本校學生選課辦法規定：研究生因課業需要，除本系（所）基本應修學分外，經本系（所）主任（所長）與指導教授及開設課程學系主任之同意，報經教務長核可後，得選修大學部相關課程，並於修習通過後計入畢業學分，但以三學分為限。						
五、承認外系（所）學分：最多 <u>12</u> 學分	含校際選課學分						
六、必修科目及學分數：共 <u>7</u> 學分 <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">科目名稱</th> <th style="text-align: right;">學分數</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. 畢業論文</td> <td style="text-align: right;">6</td> </tr> <tr> <td>2. 書報討論(一)</td> <td style="text-align: right;">1</td> </tr> </tbody> </table>	科目名稱	學分數	1. 畢業論文	6	2. 書報討論(一)	1	必修科目不及格應予重修， 必修科目未修滿不得畢業。
科目名稱	學分數						
1. 畢業論文	6						
2. 書報討論(一)	1						
七、系所指定應補修大學部基礎科目（不計入畢業學分）：共 <u>0</u> 學分	本校研究所碩士班章程規定，研究生應補修之大學部基礎課程，由系主任（所長）及指導教授決定之，但補修及格後，不計入畢業學分。未補修及格前，不得參加學位考試。						
八、碩士學位考試（論文考試）： 1. 研究生入學第一學年結束前，應商請指導教授。 2. 研究生修完最低修業年限且修畢規定課程及學分，並完成研究論文初稿者，得於當學期完成註冊選課後，於預定舉行論文考試日期至少二十天前，提出論文考試申請。論文考試成績以 70 分為及格。	論文考試成績佔畢業成績 50%  論文不及格而修業年限未屆滿者，得於次學年或次學期申請重考一次，重考仍不及格者，予以退學。重考及格者之成績，概以 70 分計算。						
九、其 他：英語能力畢業標準：由各指導教授自行要求。 碩士班學生入學後必須修習且通過至少二門核心課程始能畢業。 <u>核心課程包含以下科目：</u> <u>繞射原理、電極動力學、固態熱力學、電子顯微鏡原理、</u> <u>材料界面科學、高等固態擴散、材料缺陷、固態物理(一)。</u>	依「國立中興大學學生英文能力畢業標準檢定辦法」第 2 條規定，授權系所自訂研究生英語能力畢業標準。(98.3.26 第 57 次教務會議訂定)						

※必修科目及畢業學分數規定，由系所依各學年課程規劃表填列。

※相關章程規定查詢網址：<http://www.nchu.edu.tw/~indodep/chinese/rule.htm>

系（所）承辦人：

助教張琇雅

系主任（所長）簽章：

教授代理材料科學與工程學系系主任 吳宗明

99 年 2 月 4 日

材料科學與工程 學系碩士班畢業條件明細表(98學年度起入學適用)

專業選修科目列表

科目名稱	全或半	學分
(1) 書報討論(二)	全	0
(2) 電子顯微鏡原理	半	3
(3) 實用電子顯微鏡	半	3
(4) 繞射原理	半	3
(5) 實用繞射學	半	3
(6) 固態物理(一)	半	3
(7) 固態物理(二)	半	3
(8) 固態熱力學	半	3
(9) 電化學方法與應用	半	3
(10) 科技論文寫作	半	3
(11) 表面科學	半	3
(12) 相變化	半	3
(13) 材料接合技術	半	3
(14) 機械性質	半	3
(15) 銲接冶金	半	3
(16) 銲接技術	半	3
(17) 高等熱處理	半	3
(18) 輕金屬材料製程	半	3
(19) 陶瓷製程	半	3
(20) 凝固與鑄造	半	3
(21) 奈米製程	半	3
(22) 電漿製程技術	半	3
(23) 薄膜科學	半	3
(24) 破壞科學	半	3
(25) 脈衝表面工學	半	3
(26) 厚膜製程	半	3
(27) 高分子物理性質	半	3
(28) 光電顯示器專題	半	3
(29) 液晶材料	半	3
(30) 生醫材料	半	3
(31) 高溫材料	半	3
(32) 奈米材料	半	3
(33) 光纖材料	半	3
(34) 材料分析與檢測	半	3
(35) 磨耗學	半	3
(36) 殘留應力量測與分析	半	3
(37) 表面工程實驗	半	3
(38) 氧化動力學	半	3
(39) 非晶形材料	半	3
(40) 超大型積體電路製程	半	3

科目名稱	全或半	學分
(41) 光電材料與元件	半	3
(42) 固態化學	半	3
(43) 磁記錄原理與應用	半	3
(44) 薄膜與奈米機械分析	半	3
(45) 光電高分子材料	半	3
(46) 熱電材料	半	3
(47) 半導體製程與設備導論	半	3
(48) 物理冶金通論	半	3
(49) 奈米檢測技術	半	3
(50) 奈米與生醫光電通論	半	3
(51) 太陽光電科技導論	半	3
(52) 光資訊儲存技術	半	3
(53) 光學薄膜	半	3
(54) 高分子科學	半	3
(55) 奈米科技導論	半	3
(56) 功能性高分子材料	半	3
(57) 電子能譜表面分析	半	3
(58) 實用光學薄膜	半	3
(59) 進階磁性材料	半	3
(60) 進階薄膜製程	半	3

◎備註：

1. 本系最低應選修 12 學分。
2. 以上選修科目來自課程規劃，可能未成班或停開。
3. 本系專業選修科目如有新增等異動，請以最新學年度之課程規劃表為依據。

系承辦人：

助教張琇雅

系主任(所長)簽章：

教授代選材料科學與工程學系系主任 吳宗明

99年 > 月 4 日